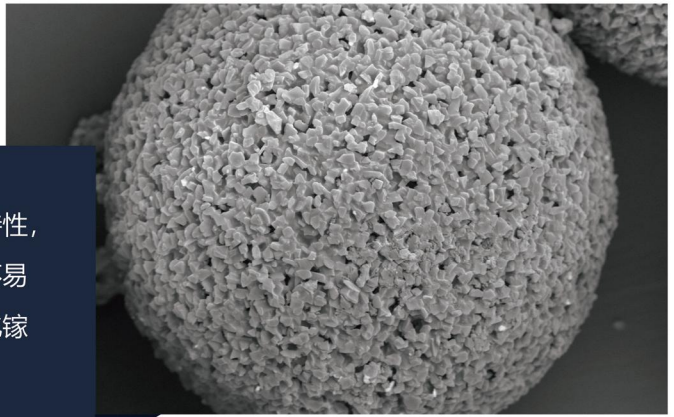


类球型团聚多晶金刚石微粉

类球型团聚多晶金刚石利用其类型多刃角的特性，在研磨抛光过程中能够保持高磨削力的同时不易产生划伤，广泛应用于蓝宝石、碳化硅、氮化镓等硬脆材质的研磨。



主要特征

- 具有球形外形特征，微观呈现多刃结构，略呈天然矿物光泽；
- 粒度分布范围窄，能得到均一的表面粗糙度；
- 能够达到超高纯度。
- 较高的切削能力，并保证高精密的抛光效果；
- 产品质量稳定，批次之间差异小；

粒度分布和应用场景

型号	原始粒径规格	粒径分布(μm)	应用场景	
		D50	加工对象	制成方式
MMP-020501	0-0.5μm	3-8μm	芯片衬底中抛	研磨液、精抛砂轮
MMP-051001	0-1μm	8-12μm	芯片衬底中抛	研磨液、精抛砂轮
MMP-152001	1-2μm	15-25μm	芯片衬底精磨	研磨液、精抛砂轮
MMP-203001	1-3μm	25-35μm	光学晶片精磨	研磨液、研磨纸
MMP-303501	2-4μm	30-40μm	陶瓷器件研磨	研磨液、研磨纸
MMP-404001	3-6μm	40-60μm	微晶玻璃精磨	钻石研磨垫、精抛砂轮

应用领域

半导体晶片加工：

主要包括蓝宝石衬底片、碳化硅衬底片、蓝宝石窗口片等；

陶瓷材料加工：

氧化锆指纹识别片、氧化锆陶瓷手机后壳及其它功能陶瓷；

金属材料加工：

不锈钢、模具钢、钛合金及其它金属材料。

包装规格

1000ct, 5000ct, 10000ct, 瓶装

储存方式

常温下储存。



联系中机新材，了解更多产品信息：

地址：深圳市南山区粤海街道高新区中国地质大学产学研基地C610

电话：0755-2691 0979 传真：0755-2691 1073 邮箱：info@micromaterial.com



立足中国·服务全球

Based on China and Serving the World